

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2024年12月26日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	太平基金 刘金、太平基金 王达婷、华西证券 卜灿华、泰康资产 李晓金、泰康资产 王嘉艺、泰康资产 陈虎、泰康资产 邹志、长江证券 蔡少东、长江证券 李佩霖、东北证券 赵敏程
会议时间	2024年12月25日 14:00-15:00 2024年12月26日 10:30-11:30 2024年12月26日 16:00-17:30
会议地点	佰维存储三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监 黄炎烽 战略部总监、投资者关系负责人 肖博天 董办工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1. 请介绍一下公司目前的产品矩阵，各类产品的营收占比如何？ A1: 公司主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，主要产品为半导体存储器，主要服务为先进封测服务，其中半导体存储器按照应用领域不同又分为嵌入式存储、PC存储、工车规存储、企业级存储和移动存储等。公司营业收入占比较大的产品类型均为嵌入式存储及PC存储，公司各类产品营业收入占比可参考公司定期报告。</p> <p>Q2. 请问公司存货情况如何？后续如何展望存货变化趋势？ A2: 2024年以来，公司采取较为中性的备货策略，以销定采，公司的库存水位整体比较稳定。未来，公司将不断优化库存管理水平，提高存货周转率。</p> <p>Q3. 公司自研主控进展如何？这一业务的发展对公司的盈利能力有什么影响？ A3: 公司积极布局芯片研发与设计领域，目前公司第一款eMMC（SP1800）国产自研主控已完成批量验证，性能优异。作为国产自研的eMMC主控芯片，SP1800以其领先的技术实力，为用户提供了更高性能、更可靠的存储解决方案。公司自研主控支持QLC颗粒，迎合手机存储QLC替代趋势；针对智能穿戴产品，公司在主控芯片的性能和功耗方面做了很多的定制和优化；同时，公司自研主控提供端到端数据保护，适合车规应用场景，从而提升产品的市场竞争力。公司将持续加大芯片设计的研发投入力度，为打造服务AI时代高性能存储器奠定坚实的技术基础，提升公司在产业链的价值占比，进而提升公司盈利能力。</p>

Q4. 公司如何看待存储解决方案厂商的发展格局？

A4：目前产业正处于突破一线客户、主流应用的机遇期，行业竞争壁垒大幅提升，龙头企业的规模效应和技术优势壁垒会进一步加强，预计行业集中度将进一步提升。公司在品牌、技术、研发封测一体化构建和资本等方面均具备先发优势，将牢牢把握未来的产业发展趋势，持续构建品牌、规模和技术壁垒。

Q5. 在车规的产品上，公司是如何规划的？

A5：公司面向汽车电子应用与工业场景打造了子品牌“佰维特存”，为汽车与工业领域的客户带来高附加值的存储解决方案。公司从介质特性研究、硬件设计、固件算法开发测试验证、存储芯片先进封测到稳定供应链、全周期客户服务，构建了全方位的存储解决方案体系，打造高可靠性、高稳定性的全品类的存储产品。公司工业级产品分为-20°C~70°C的工业标准级、-40°C~85°C的工业宽温级两大类，包括工业级 eMMC、UFS、LPDDR、SSD、内存模组、存储卡等产品，能够应用于通信基站、智能汽车、智慧城市、工业互联网、高端医疗设备、智慧金融等领域。公司推出了涵盖 eMMC、UFS、SPI NOR、LPDDR、BGA SSD、存储卡在内的全面车规存储产品矩阵，系列产品支持-40°C~105°C宽温工作环境，并满足 AEC-Q100 车规级可靠性标准，覆盖多种容量等级，为智能汽车客户提供高可靠、高稳定的一站式数据存储选择。公司车规存储相关产品已在国内头部车企及 Tier1 客户量产。

Q6. 公司坚持研发封测一体化的发展路径，自有封测产能为公司带来哪些竞争优势？

A6：公司是业内最早布局研发封测一体化的企业，从 2010 年开始就自建封测能力，有十几年的积累沉淀，存储封测的技术能力达到国内领先、国际一流的水平。基于公司研发封测一体化的布局，公司存储器产品在智能可穿戴领域具有较强的竞争优势，能够在低功耗、快响应等方面进行固件算法优化设计的同时，通过先进封测工艺能力，助力产品的轻薄小巧。在产品交付过程中，面对客户的大批量交付、急单交付等需求，公司自主封测制造能力可以确保客户交期与产品品质。公司在现有技术基础上进一步布局晶圆级先进封测能力，不断提升技术壁垒。公司通过晶圆级先进封测制造项目构建晶圆级先进封测能力，一方面可以满足先进存储封装需求，为公司研发和生产先进存储产品构建技术基础，提供相关封装产能；另一方面可以与公司存储业务协同，服务公司客户对于存算合封业务的需求，为相关客户提供封测服务。

Q7. 随着全球 AI 市场的快速发展，AI 会对公司产品发展有什么影响吗？

A7：在智能手机领域，随着 AI 大模型的广泛应用，为了最大程度展现端侧 AI 的能力，目前已有不少手机厂商开始调整其旗舰产品的存储配置，公司有望受益于 AI 手机的发展；在产品方面，公司面向 AI 手机已推出 UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP 等嵌入式存储产品，并已布局 12GB、16GB 等大容量 LPDDR 产品。在 PC 领域，AIPC 基于大模型的算力需求，对搭载大容量先进制程 DRAM 产品的需求增加，同时为了有效管理 PC 上运行的 AI 数据，也会增加对 NAND 产品的需求；公司面向 AIPC 已推出 DDR5、PCIe4.0 等高性能存储产

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

	品。在智能可穿戴领域，公司 ePOP 系列产品目前已被 Google、Meta、小天才等知名企业应用于其智能手表、智能眼镜等智能穿戴设备上，其中，公司为 Ray-Ban Meta 提供 ROM+RAM 存储器芯片，是国内的主力供应商；基于公司研发封测一体化的布局，公司产品在可穿戴领域具有较强的竞争优势，公司自研主控也将进一步增强公司产品在穿戴领域的竞争力。
附件清单	无
日期	2024 年 12 月 26 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。